

문서번호: 제20190221호

수 신:

참 조:

발 신: 테크포럼(주)

제 목: '전기/전자재료용 소재/부품 기술 및 최신동향 세미나' 안내

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 테크포럼은 2월 21일(목) 오전 10시에 한국기술센터 16층 국제회의실에서 '전기/전자재료용 소재/부품 기술 및 최신동향 세미나'를 개최합니다.
3. 본 세미나에 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

- 아 래 -

- 가. 행사명: 전기/전자재료용 소재/부품 기술 및 최신동향 세미나
- 나. 일시: 2019년 2월 21일(목) 10시~17시
- 다. 장소: 한국기술센터 16층 국제회의장
- 라. 주최/주관: 테크포럼
- 마. 세부일정

시간	주제
10:00~10:50 [트랙1]	OLED 발광 재료 개발 동향 및 향후 전망
11:00~11:50 [트랙2]	전기전자용 페놀, 에폭시 수지 연구 동향
12:00~12:50 [트랙3]	다기능성 전기전자용 나노 탄소소재 산업 현황
14:00~14:50 [트랙4]	모바일기기용 고방열 소재/부품 기술동향
15:00~15:50 [트랙5]	전기전자재료용 고기능성 스마트 패키징 점접착 소재 기술 동향
16:00~16:50 [트랙6]	고기능 전기전자용 실리콘 응용 기술

※ 발표 주제 및 일정은 연사/주최측의 사정에 의해 공지 없이 변경될 수 있습니다.

- 바. 등록비

- A. 사전결제: 253,000원(부가세/중식/자료집/PDF 포함) - 2월 20일(수) 18시까지
- B. 현장결제: 286,000원(부가세/중식/자료집/PDF 포함)

테 크 포 럼 (주)

